

「德州儀器(TI)物聯網應用系統實用級國際認證技術研討會」 表面黏著技術(SMT)紮根技展計畫

一、辦理主旨：

1. 教師於研習後，可培養學生表面黏著技術(SMT)拆與錫實作能力，落實產業界技術人才需求。
2. 教師經過短期訓練、教學分享及未來應用場域分享及交流，落實 STEAM 教育理念，未來授課可以經由實作課程帶領學生習得物聯網科技基本知能。
3. 經由教師輔導，提升學生科學創造力與創新能力之 MAKER 培養，進而落實創新之具體實踐。
4. 教師全程參與並通過認證考測後，可受聘為 TEMI 電子元件拆與錫實用級能力認證監評資格。
5. 結合產業界(德州儀器)、技專校院與高中職學校之專業學程及職業技能接軌合作。

二、對象：

技專校院與高中職學校教師

三、計畫項目：

專業師資研習(認證培訓+認證考試+監評培訓)

四、推廣範圍：

德州儀器(TI)物聯網應用系統-TEMI 電子元件拆與錫實用級能力認證

五、活動單位：

1. 主辦單位：正修科技大學工學院、電子工程系
2. 承辦單位：台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會
3. 協辦單位：德州儀器工業股份有限公司

六、活動日期/地點：

活動類別	日期	時數 (小時)	人數 (位)	報名日期	教室 考場	地點
教師培訓	2016/8/23(二)~8/24(三)	16	30	即日起至前 七天止	行政大樓 7 樓 703 嵌 入式系統應 用實驗室	高雄市鳥松區 澄清路 840 號
教師認證	2016/8/24(三)					

七、報名費用：

項目	原課程報名費 (元)	課程補助	早鳥課程補助說明	人數 (位)
教師研習	新台幣 4,800 元 培訓+認證+ 監評，原報名 費定價	由電子工程系補助 每位學員課程費用 500 元 每位學員報名費為 新台幣 4,300 元	學員於 2016/7/23(六) 以前完成報名並繳費者 每位學員早鳥報名費為 新台幣 3,300 元	30

八、執行說明：本計畫之教師研習活動說明

1. 由正修科技大學電子工程系辦理高中職校教師研習及認證。
2. 教師完成全程課程，於簽退時，可獲得由協會頒發「研習 16 小時時數證書」。
3. 教師通過認證考試，由協會頒發「電子元件拆與銲實用級能力認證證書」。
4. 教師通過監評考試，由協會頒發「電子元件拆與銲實用級能力認證-監評資格證書」。
5. 學員自行準備工具設備：
 - (1) Android 系統手機/平板做為無線控制之用。
 - (2) 請學員自行準備 AAA 電池 4 個。
 - (3) 請學員自備課程所需手工工具組(烙鐵、烙鐵架、1 號一字/十字螺絲起子、尖嘴鉗、錫絲、助焊膏油、吸錫器、SMD 鑷子)。

九、研習課程表：

課程 時間	第一天 (培訓)	第二天 (培訓+認證)
08:30~09:00	報到	
09:00~10:20	<ul style="list-style-type: none"> ● 開幕式-主辦單位長官致詞 ● TEMI 協會介紹 ● 課程說明 ● 元件辨識 ● 銲接技巧說明及實作 (基礎銲接實作 R8H) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 課程說明 ● 組裝技巧說明 ● 藍牙機器車機電組裝實作
10:20~10:30	休息	
10:30~12:00	<ul style="list-style-type: none"> ● 銲接技巧說明及實作(1) (基礎銲接實作 R8H) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 藍牙機器車測試與操控練習 (1)Android APP 安裝 (2)藍牙裝置操作說明 (3)操控練習 ● 電子元件拆與銲認證說明
12:00~13:00	午餐	
13:00~15:00	<ul style="list-style-type: none"> ● 銲接技巧說明及實作(2) SCBMH 術科認證銲接說明及實作 (彈性休息) ● 正修 SMT 生產線觀摩 	<ul style="list-style-type: none"> ● 電子元件拆與銲實用級認證 (1) 學術科認證時數：3 小時 (2) PM13:30~16:30 ● 電子元件拆與銲實用級監評認證 (1) 監評須知說明 (2) 監評考核 (3) PM16:30~17:00
15:00~15:10		
15:10~17:00		
17:00~	賦歸	

※如有變動請依當日課程安排為準，課程現場將另行展示藍牙機器船機構※

十、報名說明：

1. 學員於報名繳費後，因個人因素無法出席者，煩請以 EMAIL 告知承辦單位，退費標準如下說明：學員於開課程前(含)7 個工作天提出者，退報名費 50%，離開課前 3 個工作天提出者，恕不退費；活動單位將接獲學員通知後，於 10 個工作天內，退回相對比例之課程報名費。
2. 報名時間:即日起至開課七天前或額滿為止。
3. 報名正取說明：依先報名完成的學員優先順序，做為正取資格。
4. 報名方式：請上 TEMI 網站報名：
http://signup.temi.org.tw/?op=batch_lists&exam_cat=10&exam_rank=6

十一、 報名費繳費方式：

戶 名：台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會
銀行匯款：永豐銀行(807) 土城分行(1468)
銀行帳號：146-001-0007818-3
繳交報名費後請將繳費收據<<註明梯次編號、學校、科系、姓名>>
以掃描電子檔 e-mail 至 Alice@temi.org.tw，以確認報名順序。

十二、 活動網站：

1. 台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會：<http://www.temi.org.tw/>
2. TEMI 社團：<https://www.facebook.com/groups/temitw/>
3. TEMI 粉絲頁：<https://www.facebook.com/temi2016>

十三、 研習營諮詢：

1. 正修科技大學 電子工程系
聯絡人：施松村教授、林映岑助理
電話：(07)7310606#3232、3204
電子郵件：stshih@gcloud.csu.edu.tw、k1650@gcloud.csu.edu.tw
2. 台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會
聯絡人：王小姐
電話：(02)22239560#506
電子郵件：Alice@temi.org.tw